		TITLE PRODUCT SPECIFICATIONS	PAGE
	KSN-706	製品仕様書	1/7
PRC	DUCT No.		Date:.20180
	SNLHE010	For reference 参考	
	eneral 一般事項		
	Application 適用筆 Operating temperature r	(TACT SWITCHES : MECHANICAL CONTACT). この規格書は、キートップなしのシングルキースイッチ(タクトスイッチ:メカニカルコンタクト)について 適用	する。
1.2 \	Operating temperature r	ange 使用温度範囲: <u>40</u> , <u>50</u> , C (normal number), formal all pressure 中加 Operating temperature range shall refer to the range where this switch keeps electric. 使用温度範囲とはスイッチがON-OFF機能を維持する温度範囲を言う。	
1.3 \$	Storage temperature rar	nge 保存温度範囲:At switch level 単品状態 <u>-40</u> ~ <u>90</u> ℃ (normal humidity, norr Switch on taping テーピング状態 <u>-20</u> ~ <u>50</u> ℃ (humidity 湿度	
1.4	Test conditions 試験∜	Unless otherwise specified, the atmospheric conditions for making measurements and 試験及び測定は特に規定がない限り以下の標準状態のもとで行う。 Normal temperature 常 温: (Temperature 温度 5~35℃) Normal humidity 常 湿: (Relative humidity 湿度 25~85%)	tests are as follows.
		Normal air pressure 常 压: (Air pressure 気圧 86~106kPa{860~106	Ombar})
		If any doubt arise from judgement, tests shall be conducted at the following conditions ただし、判定に疑義を生じた場合は以下の基準状態で行う。	-
		Ambient temperature 温 度: 20±2℃ Polativo humidity 和対況度: 60~70%	
		Relative humidity 相対湿度:60~70% Air pressure 気 圧:86~106kPa{860~1060mbar}	
		Air pressure π , π : 80~100kPa{800~1000mbar} Switch shall be mounted on PWB without any indication of switch floating.	
		スイッチは回路基板から浮かないように取り付ける。	
3. TY	pe of actuating 到作市	えて <u>Tactile feedback</u> <u>タクティールフィードバック</u>	
5. Rat 5.1 I 5.2 I	ontact arrangement 回 itings 定格 Maximum ratings 最大 Minimum ratings 最小5	 (Details of contact arrangement are given in the assembly drawings 回路の詳細 定格 <u>16</u> V DC <u>50 m</u> A 定格 <u>1</u> V DC <u>10 µ</u> A	日は製品図による)
5. Rat 5.1 I 5.2 I	ntings 定格 Maximum ratings 最大 Minimum ratings 最小5 ectrical specification 冒	(Details of contact arrangement are given in the assembly drawings 回路の詳細 定格 <u>16</u> V DC <u>50 m</u> A 定格 <u>1</u> V DC <u>10 µ</u> A	
5. Ra 5.1 I 5.2 I 6. Ele	ntings 定格 Maximum ratings 最大 Minimum ratings 最小 ectrical specification 電 Items 項目	(Details of contact arrangement are given in the assembly drawings 回路の詳細 定格 <u>16</u> V DC <u>50 m</u> A 定格 <u>1</u> V DC <u>10 µ</u> A 意気的性能 Test conditions 試験条件	Criteria 判 定 基 準
5. Ra 5.1 I 5.2 I 6. Ele	ntings 定格 Maximum ratings 最大 Minimum ratings 最小5 ectrical specification 冒	(Details of contact arrangement are given in the assembly drawings 回路の詳細 定格 <u>16</u> V DC <u>50 m</u> A 定格 <u>1</u> V DC <u>10 µ</u> A	
5. Rat 5.1 I 5.2 I 6. Ele	ntings 定格 Maximum ratings 最大 Minimum ratings 最小 ectrical specification 電 Items 項目 Contact resistance 接触抵抗	(Details of contact arrangement are given in the assembly drawings 回路の詳細定格 定格 16 V DC 50 mA 定格 1 V DC 10 \mu 氢的性能 氢的性能 Applying a below static load to the center of the stem, measurements shall be made. スイッチ操作部中央に下記の静荷重を加え、測定する。 (1) Depression 押圧力: 10 N (2) Measuring method 測定方法: 1 kHz small-current contact resistance meter or voltage drop method at 5VDC 10mA. 1kHz微少電流接触抵抗計,又はDC5V 10mA電圧降下法	Criteria 判定基準 <u>100 m</u> Ω Max.
5. Rat 5.1 I 5.2 I 6. Ele	atings 定格 Maximum ratings 最大 Minimum ratings 最小 actrical specification Items 項目 Contact resistance 接触抵抗	(Details of contact arrangement are given in the assembly drawings 回路の詳細 定格 16 V DC 50 mA 定格 1 V DC 10 µA 氢気的性能 Test conditions 試験条件 Applying a below static load to the center of the stem, measurements shall be made. スイッチ操作部中央に下記の静荷重を加え、測定する。 (1) Depression 押圧力: 10 N (2) Measuring method 測定方法: 1 kHz small-current contact resistance meter or voltage drop method at 5VDC 10mA. 1kHz微少電流接触抵抗計,又はDC5V 10mA電圧降下法 Measurements shall be made following the test set forth below:	Criteria 判 定 基 準
5. Rat 5.1 I 5.2 I 6. Ele	ntings 定格 Maximum ratings 最大 Minimum ratings 最小 ectrical specification 電 Items 項目 Contact resistance 接触抵抗	(Details of contact arrangement are given in the assembly drawings 回路の詳細 定格 16 V DC 50 mA 定格 1 V DC 10 µA 氢気的性能 Test conditions 試験条件 Applying a below static load to the center of the stem, measurements shall be made. スイッチ操作部中央に下記の静荷重を加え、測定する。 (1) Depression 押圧力: 10 N (2) Measuring method 測定方法:1 kHz small-current contact resistance meter or voltage drop method at 5VDC 10mA. 1kHz微少電流接触抵抗計,又はDC5V 10mA電圧降下法 Measurements shall be made following the test set forth below: 下記条件で試験を行った後、測定する。	Criteria 判定基準 <u>100 m</u> Ω Max.
5. Rat 5.1 I 5.2 I 6. Ele	ntings 定格 Maximum ratings 最大 Minimum ratings 最小 ectrical specification 雷 Items 項目 Contact resistance 接触抵抗	(Details of contact arrangement are given in the assembly drawings 回路の詳細 定格 16 V DC 50 mA 定格 1 V DC 10 µA 氢気的性能 Test conditions 試験条件 Applying a below static load to the center of the stem, measurements shall be made. スイッチ操作部中央に下記の静荷重を加え、測定する。 (1) Depression 押圧力: 10 N (2) Measuring method 測定方法:1 kHz small-current contact resistance meter or voltage drop method at 5VDC 10mA. 1kHz微少電流接触抵抗計,又はDC5V 10mA電圧降下法 Measurements shall be made following the test set forth below: 下記条件で試験を行った後、測定する。	Criteria 判定基準 <u>100 m</u> Ω Max.
5. Ra 5.1 I 5.2 I 6. Ele	ntings 定格 Maximum ratings 最大 Minimum ratings 最小 ectrical specification 雷 Items 項目 Contact resistance 接触抵抗	(Details of contact arrangement are given in the assembly drawings 回路の詳細 定格 <u>16</u> V DC <u>50 m</u> A 定格 <u>1</u> V DC <u>10 µ</u> A ③気的性能 <u>Test conditions</u> 試験条件 Applying a below static load to the center of the stem, measurements shall be made. スイッチ操作部中央に下記の静荷重を加え,測定する。 (1) Depression 押圧力: <u>10</u> N (2) Measuring method 測定方法: 1 kHz small-current contact resistance meter or voltage drop method at 5VDC 10mA. 1kHz微少電流接触抵抗計,又はDC5V 10mA電圧降下法 Measurements shall be made following the test set forth below: 下記条件で試験を行った後,測定する。 (1) Test voltage 印加電圧: <u>100</u> V DC for 1 min.	Criteria 判定基準 <u>100 m</u> Ω Max.
5. Rat 5.1 I 5.2 I 6. Ele	ntings 定格 Maximum ratings 最大 Minimum ratings 最小 ectrical specification 雷 Items 項目 Contact resistance 接触抵抗	(Details of contact arrangement are given in the assembly drawings 回路の詳細 定格 <u>16 V DC 50 mA</u> 定格 <u>1 V DC 10 µ</u> A 認気的性能 てest conditions 試験条件 Applying a below static load to the center of the stem, measurements shall be made. スイッチ操作部中央に下記の静荷重を加え,測定する。 (1) Depression 押圧力: <u>10 N</u> (2) Measuring method 測定方法: 1 kHz small-current contact resistance meter or voltage drop method at 5VDC 10mA. 1kHz微少電流接触抵抗計,又はDC5V 10mA電圧降下法 Measurements shall be made following the test set forth below: 下記条件で試験を行った後,測定する。 (1) Test voltage 印加電圧: <u>100 V DC for 1 min.</u> (2) Applied position 印加場所:Between all terminals. And if there is a metal frame,	Criteria 判定基準 <u>100 m</u> Ω Max.
5. Rat 5.1 I 5.2 I 6. Ele 6.1	ntings 定格 Maximum ratings 最大 Minimum ratings 最小 ectrical specification 電 Items 項目 Contact resistance 接触抵抗	(Details of contact arrangement are given in the assembly drawings) 回路の詳細 定格 16 V DC 50 mA 定格 1 V DC 10 \muA 意気的性能 Test conditions 試 験 条 件 Applying a below static load to the center of the stem, measurements shall be made. スイッチ操作部中央に下記の静荷重を加え、測定する。 (1) Depression 押圧力: 10 N (2) Measuring method 測定方法: 1 kHz small-current contact resistance meter or voltage drop method at 5VDC 10mA. 1kHz微少電流接触抵抗計,又はDC5V 10mA電圧降下法 Measurements shall be made following the test set forth below: 下記条件で試験を行った後、測定する。 (1) Test voltage 印加電圧: 100 V DC for 1 min. (2) Applied position 印加場所:Between all terminals. And if there is a metal frame, between terminals and ground(frame) 端子間、金属フレームがある場合は、端子と金属フレーム間	<u>Criteria</u> 判定基準 <u>100 m</u> Ω Max. <u>100 M</u> Ω Min.
5. Rat 5.1 I 5.2 I	ntings 定格 Maximum ratings 最大 Minimum ratings 最小 ectrical specification 雷 Items 項目 Contact resistance 接触抵抗	(Details of contact arrangement are given in the assembly drawings 回路の詳細 定格 16 V DC 50 mA 定格 1 V DC 10 µA 認気的性能 Test conditions 試験条件 Applying a below static load to the center of the stem, measurements shall be made. スイッチ操作部中央に下記の静荷重を加え、測定する。 (1) Depression (1) Depression 押圧力: 10 N (2) Measuring method 測定方法: 1 kHz small-current contact resistance meter or voltage drop method at 5VDC 10mA. 1kHz微少電流接触抵抗計,又はDC5V 10mA電圧降下法 Measurements shall be made following the test set forth below: 下記条件で試験を行った後、測定する。 (1) Test voltage 印加電圧: 100 V DC for 1 min. (2) Applied position 印加場所:Between all terminals. And if there is a metal frame, between terminals and ground(frame) 端子間,金属フレームがある場合は、端子と金属フレーム間 Measurements shall be made following the test set forth below: 下記条件で試験を行った後、測定する。 (1)Test voltage 印加電圧 : 250 V AC (50~60Hz) (2)Duration 印加時間 : 1 min (3)Applied position 印加場所 :Between all terminals. And if there is a metal frame, between 印加電氏	Criteria 判定基準 <u>100 m</u> Ω Max.
5. Ra 5.1 I 5.2 I 6. Ele 3.1	ntings 定格 Maximum ratings 最大 Minimum ratings 最小 ectrical specification Items 項目 Contact resistance 接触抵抗 Insulation resistance 絶縁抵抗	(Details of contact arrangement are given in the assembly drawings) 回路の詳細 定格 1 V DC 10µA 宮気的性能 Test conditions 試験条件 Applying a below static load to the center of the stem, measurements shall be made. スイッチ操作部中央に下記の静荷重を加え、測定する。 (1) Depression 押圧力: 10 N (2) Measuring method 測定方法:1 kHz small-current contact resistance meter or voltage drop method at 5VDC 10mA. 1kHz微少電流接触抵抗計,又はDC5V 10mA電圧降下法 Measurements shall be made following the test set forth below: 下記条件で試験を行った後、測定する。 (1) Test voltage 印加電圧: 100 V DC for 1 min. (2) Applied position 印加電圧: Measurements shall be made following the test set forth below: 下記条件で試験を行った後、測定する。 (1) Test voltage 印加電圧: 100 V DC for 1 min. (2) Applied position 印加場所:Between all terminals. And if there is a metal frame, between terminals and ground(frame) 端子間, 金属フレームがある場合は, 端子と金属フレーム間 Measurements shall be made following the test set forth below: 下記条件で試験を行った後、測定する。 (1)Test voltage 印加電匠: 250 V AC (50~60Hz) (2)Duration 印加時間:: 1 min (3)Applied position 印加場所:Betwe	Criteria 判定基準 <u>100 m</u> Ω Max. <u>100 M</u> Ω Min. There shall be no breakdown.
5. Ra 5.1 I 5.2 I 6. Ele 3.1	ntings 定格 Maximum ratings 最大 Minimum ratings 最小 ectrical specification Items 項目 Contact resistance 接触抵抗 Insulation resistance 絶縁抵抗	(Details of contact arrangement are given in the assembly drawings 回路の詳細 定格 16 V DC 50 mA 定格 1 V DC 10 µA 認気的性能 Test conditions 試験条件 Applying a below static load to the center of the stem, measurements shall be made. スイッチ操作部中央に下記の静荷重を加え、測定する。 (1) Depression (1) Depression 押圧力: 10 N (2) Measuring method 測定方法: 1 kHz small-current contact resistance meter or voltage drop method at 5VDC 10mA. 1kHz微少電流接触抵抗計,又はDC5V 10mA電圧降下法 Measurements shall be made following the test set forth below: 下記条件で試験を行った後、測定する。 (1) Test voltage 印加電圧: 100 V DC for 1 min. (2) Applied position 印加場所:Between all terminals. And if there is a metal frame, between terminals and ground(frame) 端子間,金属フレームがある場合は、端子と金属フレーム間 Measurements shall be made following the test set forth below: 下記条件で試験を行った後、測定する。 (1)Test voltage 印加電圧 : 250 V AC (50~60Hz) (2)Duration 印加時間 : 1 min (3)Applied position 印加場所 :Between all terminals. And if there is a metal frame, between 印加電氏	Criteria 判定基準 <u>100 m</u> Ω Max. <u>100 M</u> Ω Min. There shall be no breakdown.

DOCL	IMENT No. KSN-706	TITLE PRODUCT SPECIFICATIONS		PAGE 2/7
PRODUCT No. SKSNLHE010		製品仕様書		Date:.201805
		For reference 参考		
6.4	Items 項目 Bounce バウンス	Test conditions 試験条件 Lightly striking the center of the stem at a rate encountered in normal use (3 to 4 operations per s.), bounce shall be tested at "ON" and "OFF". スイッチ操作部の中央部を通常の使用状態(3~4回/秒)で軽く打鍵し、ON時及びOFF時のパウンスを測定する。 Switch Switch Switch Oscilloscope Total Oscilloscope Total ON" ON" Operation of the stem at a rate encountered in normal use (3 to 4	Criteria ON bounce : <u>20</u> OFF bounce: <u>20</u>	_
7. Me	l chanical specification	 機械的性能		
7.1	Items 項目 Operating force 作動力	Test conditions試験条件Placing the switch such that the direction of switch operation is vertical and then gradually increasing the load applied to the center of the stem, the maximum load required for the switch to come to a stop shall be measured. スイッチの操作方向が垂直になる様にスイッチを設置し,操作部中央部に徐々に荷重を加 え,操作部が停止するまでの最大荷重を測定する。	Criteria	判 定 基 準
7.2	Travel 移 動 量	Placing the switch such that the direction of switch operation is vertical and then applying a below static load to the center of the stem, the travel distance for the switch to come to a make "ON" shall be measured スイッチの操作方向が垂直になる様にスイッチを設置し,操作部中央部に以下の静荷重を加え,スイッチがONするまでの距離を測定する。 (1) Depression 押圧力: <u>6</u> N	<u>0.2</u> ± <u>0.1</u> mm	
7.3	Return force 復 帰 力	The sample switch is installed such that the direction of switch operation is vertical and, upon depression of the stem in its center the travel distance, the force of the stem to return tot its free position shall be measured. スイッチの操作方向が垂直になる様にスイッチを設置し,操作部中央部を移動量押圧後,操 作部が復帰する力を測定する。	<u>0.2</u> N Min.	
7.4	Stop strength ストッパー強度	Placing the switch such that the direction of switch operation is vertical and then a below static load shall be applied in the direction of stem operation. スイッチの操作方向が垂直になる様にスイッチを設置し、スイッチの操作方向へ以下の静荷重を加える。 (1) Depression 押圧力: <u>50</u> N (2) Time 時間: <u>15</u> s (3) Number of times 回数: <u>1</u> times 	Keep electrical ON 電気的にON-OFF Item6.1	
8. Env	ironmental specification			
8.1	Items 項目 Resistance to low temperatures 耐寒性	Test conditions 試験条件 Following the test set forth below the sample shall be left in normal temperature and humidity conditions for 1 h before measurements are made: 次の試験後,常温,常湿中に1時間放置後測定する。 (1) Temperature 温度:40 ± 2 °C (2) Time 時間:1000 h (3) Waterdrops shall be removed. 水滴は取り除く。	Criteria Item 6. Item 7.1 Item 7.2	1 判 定 基 準
8.2	Heat resistance 耐熱性	Following the test set forth below the sample shall be left in normal temperature and humidity conditions for 1 h before measurements are made: 次の試験後, 常温, 常湿中に1時間放置後測定する。 (1) Temperature 温 度: <u>90</u> ±2 ℃ (2) Time 時 間: <u>1000 h</u>	Item 6. Item 7.1 Item 7.2	
8.3	Moisture resistance 耐湿性	Following the test set forth below the sample shall be left in normal temperature and humidity conditions for 1 h before measurements are made: 次の試験後, 常温, 常湿中に1時間放置後測定する。 (1) Temperature 温度: <u>60</u> ±2°C (2) Time 時間: <u>1000</u> h (3) Relative humidity 相対湿度: <u>90</u> ~ <u>95</u> % (4) Waterdrops shall be removed. 水滴は取り除く。	<u> 500 m</u> Ω Max.	接触抵抗(Item 6.1) : e 絶縁抵抗(Item 6.2) :

DOC	JMENT No. TITLE PRODUCT SPECIFICATIONS		PAGE	
	KSN-706 製品仕様書		3⁄7	
PRODUCT No. SKSNLHE010		For reference 参考		Date:.20180
	Items 項目	Test conditions 試験条件	Criteria	判 定 基 準
3.4	Change of temperature 温度サイクル	After below cycles of following conditions, the switch shall be allowed to stand under normal room temperature and humidity conditions for 1 h, and measurement shall be made. Water drops shall be removed. 下記条件で以下回数のサイクル試験後、常温常湿中に1時間放置し測定する。 ただし、水滴は取り除く。 A	Item 6. Item 7.1 Item 7.2	
		$B = -40 ^{\circ}C$ $C = 2 h$ $D = 1 h$ $E = 2 h$ $F = 1 h$ $F = 1 h$ $C = 166 \text{ cycles}$ $T = 166 \text{ cycles}$		
3.5	Resistance to hydrogen sulfide gas.(H₂S) 耐硫化ガス性	Following the test set forth below the sample shall be left in normal temperature and humidity conditions for 1 h, and shall be operated two or three times before measurements are made: 次の試験後,常温,常湿中に1時間放置し、2~3回切り換えた後,測定する。 (1) Concentration of H ₂ S gas. H ₂ Sガス濃度: <u>1</u> ppm (2) Temperature 温度: <u>40</u> ± <u>2</u> °C (3) Relative humidity 相対湿度: <u>75</u> ± <u>5</u> % (4) Time 時間: <u>240</u> h	Contact resistance <u>1</u> Ω Max.	接触抵抗(Item 6.1):
3.6	Resistance to sulfur dioxide (SO ₂) 耐亜硫酸ガス性	Following the test set forth below the sample shall be left in normal temperature and humidity conditions for 1 h, and shall be operated two or three times before measurements are made: 次の試験後,常温,常湿中に1時間放置し、2~3回切り換えた後,測定する。 (1) Concentration of SO₂ gas. SO₂ガス濃度: 10 ppm (2) Temperature 温度: 40 °C (3) Relative humidity 相対湿度: 75 % (4) Time 時間: 240 h	Contact resistance <u>1</u> Ω Max.	接触抵抗(Item 6.1):
. Enc	lurance specification	耐久性能		
	Items 項 目	Test conditions 試験条件	Criteria	判 定 基 準
9.1	Operating life 動作寿命	Measurements shall be made following the test set forth below: 下記条件で試験を行った後, 測定する。 (1) <u>5</u> VDC <u>5</u> mA resistive load 抵抗負荷 (2) Rate of operation 動作速度: <u>2</u> to <u>3</u> operations per s 回/秒 (3) Depression 押圧力: <u>6</u> N (4)Cycles of operation 動作回数: <u>100,000</u> cycles 回	<u>20</u> Ω Max.	_ms Max. _ms Max. 動力(Item 7.1) :
			1.6111 /.2	

		(5)Direction of vibration: Three mutually perpendicular directions, including the direction 振動の方向 of the travel スイッチ操作方向を中心とした垂直3方向 (6)Duration 振動時間: <u>2</u> h each (<u>6</u> h in total) 各 <u>2</u> 時間 (計 <u>6</u> 時間)	
9.3	Shock 耐 衝 撃 性	Measurements shall be made following the test set forth below: 下記条件で試験を行った後,測定する。 (1)Acceleration 加速度: <u>784</u> m/s ² (2)Acting time 作用時間: <u>6</u> msec (3)Test direction 試験方向: 6 directions 6 面 (4)Number of shocks 試験回数: <u>3</u> times per direction (<u>18</u> times in total) 各方向各 <u>3</u> 回(計 <u>18</u> 回)	Item 6.1 Item 7.1 Item 7.2

掃引の割合: <u>10-55-10</u> Hz Approx. <u>1</u>min 約<u>1</u>分

対数又は一様掃引

Measurements shall be made following the test set forth below:

(1)Vibration frequency range 振動数範囲:<u>10</u>~<u>55</u>Hz (2)Total amplitude 全振幅:<u>1.5</u>mm

(4)Method of changing the sweep vibration frequency : Logarithmic or uniform

下記条件で試験を行った後,測定する。

掃引振動数の変化方法

(3)Sweep ratio

Item 6.1

Item 7.1

Item 7.2

ALPS ELECTRIC CO., LTD.

9.2

Vibration resistance

耐 振 性

	IENT No. SN—706	TITLE PRODUCT SPECIFICATIONS 製品仕様書	PAGE 4⁄7
PRODU	CT No.		Date:.201805
SKSNI	_HE010	For reference 参考	
0. Solde	ering conditions 半日		L
	 Items 項 目	Recommended conditions 推 奖 条 件	
	Hand soldering 手 半 田	Please practice according to below conditions. 以下の条件にて実施して下さい。 (1)Soldering temperature 半田温度: <u>350</u> °C Max. (2)Continuous soldering time 連続半田時間: <u>3</u> s Max. (3)Capacity of soldering iron 半田コテ容量: <u>20</u> W Max. (4)Excessive pressure shall not be applied to the terminal. 端子に異常加圧のないこと	
	Reflow soldering Jフロ―半田	Please practice according to below conditions. 以下の条件にて実施して下さい。 (1)Profile 温度プロファイル Surface of product Temperature 部品表面温度(°C) 230 180 150 150 150 120 <u>s</u> Max (Pre-heating 予熱) <u>3~4 min. Max.</u> Time inside soldering equipment 炉内通過時間	
F 	Other precautions For soldering 半田付けに関する その他注意事項	 (2)Allowable soldering time 半田回数: <u>2</u> time Max. (The temperature shall go down to a normal temperature in prior to exposure to the second time : 2回目を行う場合には、スイッチが常温に戻ってから行うこと。) (1)Switch terminals and PWB. Upper face shall be free from flax prior to soldering. 事前にスイッチの端子及びプリント基板の部品実装面上にフラックスが塗られていないこと。 (2)Following the soldering process, do not try to clean the switch with a solvent or the like. 半田付け後、溶剤などでスイッチを洗浄しないで下さい。 (3) Recommended cream solder : M705-GRN360-K2-V (SENJU METAL INDUSTRY CO.,LTD) or equivalent 推奨クリーム半田:千住金属工業(株) M705-GRN360-K2-V 同等品 (4) When chip components is soldered on the back side of PWB by automatic flow soldering, after this switch soldered flux will possibly creep up at the exterior wall of the housing and penetrate into the housing due to flux ejection. The designed, please do not locate through holes adjacent to the switch mounted area. 本スイッチをリフロー半田後、プリント基板裏面をディップ半田して使用する場合は、ディップ時のフラックス吹き上げ等 フラックスがはい上がる場合がありますので、パターン設計にあたってはスイッチ下面、周囲にスルーホールを設けない (5) As the conditions vary somehow depending on the kind of reflow soldering equipment, please make sure you have support. 	refore, when the PWB is によりスイッチ側面から いで下さい。



DOCUMENT No.	TITLE PRODUCT SPECIFICATIONS	PAGE
KSN-706	製品仕様書	5⁄7
		Date:.201805
PRODUCT No.	For reference 参考	Date201000
SKSNLHE010		
【Precaution in use】ご使用上	の注意	
formalities of such laws and	s which are controlled items subject to foreign and domestic export laws and regulations, you must obtain approv d regulations. より規制されている製品の輸出に際しては、同法規を遵守の上、必要な許可、手続き等をとってください。	ral and/or follow the
A2. Products must not be used purposes.	d for military and/or antisocial purposes such as terrorism, and shall not be supplied to any party intending to us	e the products for such
	L会活動目的では、当製品を一切使用しないでください。また、最終的にそれら用途・目的で使用されるおそれがま いでください。	らる法人・団体・個人等
such as AV (audio visual)ed equipment. The products an other unauthorized use. Wit equipment, burglar alarm ed system on the applicability. system for safety and relial 当製品は、特に用途を指定 したがいまして、原子力制御 防災機器、海底用機器等の	, the products have been designed and manufactured for application to equipment and devices which are sold to quipment, home electric equipment, office and commercial electronic equipment, information and communication re not intended for use in, and must not be used for, any application of nuclear equipment, driving control equipment, the exception of the above mentioned banned applications, for applications involving high levels of safety and quipment, disaster prevention equipment and undersea equipment, please contact an Alps sales representative a Also, implement a fail-safe design, protection circuit, redundant circuit, malfunction protection and/or fire protebility of the total system. していないかぎり、本来、AV、家電、事務機、情報機器、通信機器、アミューズメント機器等の一般電子機器用に調機器、宇宙・航空機で運行にかかわる機器等の用途では一切使用しないでください。上記の使用禁止の用途以 の高度の安全性・信頼性を必要とする機器でのご使用の際は、弊社営業担当迄ご相談いただくか、またはセットで	equipment or amusement nent for aerospace or any liability such as medical nd/or evaluate the total action into the complete 設計、製造されたものです。 外で、医療機器、防犯機器、 の十分な適合性の確認を
車載対応製品以外の製品る	ch were not specifically designed for use in automotive applications, please contact an Alps sales representative を車載用にご使用される場合は、事前に弊社へご相談ください。	
capacitive (C)), please let u	nd manufactured assuming that it is to be used with the resistance for direct current. If you use other kinds of ro is know beforehand. を想定して設計・製造されています。その他の負荷(誘導性負荷(L),容量性負荷(C))で使用される場合は,別途	
B1. Note that if the load is app	PWBoard process 半田付, 基板実装工程 blied to the terminals during soldering they might suffer deformation and defects in electrical performance. 合、端子に荷重が加わりますと条件によりガタ、変形及び電気的特性劣化のおそれがありますのでご注意下さい	0
B2. Conditions of soldering sha	all be confirmed under actual production conditions. はんだ付けの条件の設定については、実際の量産条件で研	宦認されるようお願いします。
	this switch, this switch is not allowed for wave/flow soldering at the backside of PWB. Due to jet stream, flux may p き、プリント基板裏面をディップ半田しないで下さい。フラックス吹き上げによりスイッチにフラックスが侵入する場合	
_	riorate when heat is applied repeatedly, reflow soldering should be done within the recommended conditions. 惑が低下する可能性がありますので推奨リフロー条件以内でリフローを行う様にお願いします。	
When the switch is carried ステムに横からの力が加れ	from the side, it may result in damages to switch functions. Therefore please handle it with extreme care. , any shock shall not be applied to the stem. つりますと, スイッチの機能破壊につながる危険性がありますので取扱いは十分注意して下さい。 奇撃が加わらない様に注意して下さい。	
	rithout any indication of switch floating between switch bottom and PWB. の間に隙間が生じないように取り付けてください。	
-	lly when you use any other type of solder except recommended one. D際は十分ご注意願います。	
	呈 ocess, do not try to clean the switch with a solvent or the like. ッチを洗浄しないでください。	

D. Mechanism design(switch layout) 機構設計

D1. When users use a different PWB mounting hole and land footprints/pattern from our recommended dimensions, the prior consultation shall be made with us. プリント基板取り付け穴およびパターンに関し、推奨寸法以外を採用する場合は、当社に連絡願います。

D2. You may dip-solder chip components on the backside of PWB after you have reflow-soldered this switch. However, dip-soldering may cause flux to creep up on the wall of the housing and penetrate the switch. Therefore, do not design a throughhole under and around the switch. 本スイッチをリフロー半田後, プリント基板裏面をディップ半田して使用する場合は, ディップ時のフラックス吹き上げ等により, スイッチ側面より, フラックスがはい上がる場合がありますので, パターン設計にあたっては, スイッチ下面, 周囲にスルーホールを設けないで下さい。

D3. Do not use the switch in a manner that the stem will be given stress from the side. If you push the stem from the side, the switch may be broken. ステムを横方向から押す様な使い方は避けて下さい。ステム先端に横方向から荷重が加わりますとスイッチが破壊される場合があります。

D4. Press the center of the stem. Click feel may be changed, if you press the edge. This is because the center will be displaced, depending on the hinge structure or cumulative tolerances. When you use the hinge structure, take special care so that the keytop point to press the switch won't move. ステムのセンターを押す様にして下さい。ヒンジ構造及びセット上の累積公差によるセンターズレなどステムを端押しする状態では感触が変化する場合があります。ヒンジ構造の場合は、押下時ステム押し位置が移動しますので、特にご注意下さい。

DOCUMENT No.	TITLE PRODUCT SPECIFICATIONS	PAGE
KSN-706	製品仕様書	6⁄7
PRODUCT No. SKSNLHE010	For reference 参考	Date:.201805
Please avoid using this swite	nit construction that it is pressed by human operation. ch as mechanical detecting function. In case such detecting function is required, please consult wit fを介してスイッチを押す構造にてご使用下さい。メカ的な検出機能へのご使用は、避けてください。 ッチをご使用下さい。	
D6. Switch shall not be kept pres スイッチを長時間ONさせる使		
(Refer to the strength of the s	you give larger stress than specified. Take most care not to let the switch be given larger stress th stopper.))荷重が加わるとスイッチが破損する場合が有ります。スイッチに規定荷重以上の力が加わらない様	
switch.	sed and/or operated at any impact force. When switch is pressed at impact force, this may potent ないで下さい。衝撃が加わりますとスイッチが破損する危険性があります。	ially cause damage or breakage of
Sheet. In prior to implement. タクトスイッチの基板実装後	/B assembly might cause broken switch due to vibration, depending on the welding conditions e.g. b ation of such ultrasonic welding, please well check that welding process would not cause any issue 、超音波溶着を実施される場合は事前にタクトスイッチに異常が生じないか確認を行ってください。 チに振動が加わりスイッチが破損する可能性があります。不具合例:カシメ部破損、防塵/防水シー	e to our product.
	way of the switch being used on your module, please let us know. れ方が変更される際は当社に御連絡ください。	
	op to be projecting from set case. This may cause breakage of switch due to mechanical impact ap 本から出るようなご使用方法はお避け下さい。スイッチに衝撃荷重が加わりスイッチ破壊の原因とな	
D12. Please make sure that switc 基板がたわむような場所へ	ch is mounted without any flexure of PWB. の設置はお避け下さい。	
	『先端形状 tip of the keying section is to be flat (¢2.5). Also ABS or PC resign is recommended for its mat いたします。尚、材質はABSまたはPC等の樹脂を推奨いたします。	erial.
D14. The inclination of the strikin 打鍵部の傾斜は2度以内に		
	m. If the keytop is displaced, it might impact degradation in electrical and mechanical performance. ごさい。ステム天面からキートップ先端が外れると、電気的・機械的特性が劣化する恐れがあります。	
care due to the switch perfor	s used around a sulfurate hot spring where sulfide gas is generated or in a place where exhaust gas	
同ーセット内に以下の様な部 ・For parts,rubber materia generate gas of sulfuriza 部品, ゴム材料, 接着発 ・When you use silicon ru form silicon dioxide coat シリコン系ゴム, グリー とSW接点部に2酸化現 ・When you apply chemica	ave parts/materials described below within the module where the switch is installed. 材に関しましては以下の点にご注意願います。 als,adhesive agents,plywood,packing materials and lubricant used for the mechanical part of the dev ation or oxidization. 剤, 合板, 機器の梱包材, 機器内の駆動部に使用される潤滑剤については, 硫化, 酸化ガスを発生 bber, grease, adhesive agents and oil, use those that will not generate low molecular siloxane gas. t on the SW contact part, resulting in the contact failure. ス, 接着剤, オイルを使用される場合は, 低分子シロキサンガスを発生しないものを使用してください 基素の被膜を形成して接点障害を引き起こす場合があります。 al agents such as coating agents to the products, please let us know beforehand. 等の薬品を付着させる場合は, 別途ご相談ください。	しないものを採用してください。 The low molecular siloxane gas may

E3. Do not use this switch in the atmosphere with high humidity or with bedewing probability, because such atmosphere may cause leak among terminals.

高湿度環境下,又は結露する可能性がある環境では,端子間の電流リークが発生する可能性が有りますので本スイッチはご使用にならないでください。

DOCUMENT No.	TITLE PRODUCT SPECIFICATIONS	PAGE
KSN-706	製品仕様書	7/7
		 Date:.201805
PRODUCT No.	For reference 参考	Date201000
SKSNLHE010		
F. Storage method. 保管方法		
_	ironment shall be avoided. This product may face an increase in contact resistance and degraded solderab 「期間で保管されますと接触抵抗の上昇やはんだ付け性の悪化が発生する恐れがありますので避けてくだ	-
(2)Corrosive gas 腐食性ガン		以上の環境
(3) Longer than 6-month sto Direct exposure to sunlight 直射	rage after being delivered 製品納入後6ヶ月超える長期保管。 †日光の当たる場所。	
F2. After you break the seal, you You should use it up as soon	i should put the remaining in a plastic bag to separate it from the outside and store it in the same environ as possible.	ment mentioned above.
開封後はポリフクロで外気と	の遮断を図り上記と同じ環境下で保管しすみやかにご使用下さい。	
F3. Do not stack too many switc 過剰な積み重ねは行わないで		
-	released position, when they are stored. ったままでの保存はしないでください。	
-	alid one year after it is issued, if you don't return it or don't place an order. 間を経過して, ご返却又はご発注の無い場合は, 無効とさせていただきます。	
	specifications other than electric and mechanical characteristics and outside dimensions may be changed 寸法および取付寸法以外につきましては, 当社の都合により変更させて頂く事が有りますので, あらかじめ	
you must take certain protec	nd the rating. It may catch fire. If you think that the product may be used beyond the rating due to some a stive measures, such as a protective circuit to shut down the current. 第発生のおそれがありますので絶対に避けて下さい。また異常使用等で定格を超える恐れがある場合は保護	
G4. The flammability grade of the catch fire, or take measures	e plastic used for this product is ["] 94HB ["] by the UL Standard (slow burning). Therefore, either refrain from s to preclude catching fire. 等の燃焼グレードはUL規格の"94HB"(遅燃性グレード)相当を使用しております。 つきましては類焼の恐	
禁止するか, 類焼防止対策	をお願いします。	
requiring higher safety, we v And securesafety as a whol スイッチの品質には万全を尽	switch quality, we cannot deny the possibility that they could fail due to short or open circuit. Therefore, i vould like you to verify in advance what effects your module would receive in case the switch in case the e system by introducing the fail-safe design, i.e. a protection network. くしていますが故障モードとしてショート、オープンの発生が皆無とは言えません。安全性が重視されるセッ ての影響を事前にご検討いただき、保護回路、等のフェールセーフ設計のご検討を十分に行い安全を確保し	switch alone should fail. 小の設計に際しては、スイッチの単
G6. TACT Switch is trademark o	r registered trademark of ALPS ELECTRIC CO.,LTD 気株式会社の商標もしくは登録商標です。	